

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年1月2日(02.01.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/004697 A1

(51) 国際特許分類:

G03F 7/038 (2006.01) G03F 7/004 (2006.01)
C08G 59/40 (2006.01) H01L 23/29 (2006.01)
C08G 59/62 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
C08G 73/10 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/020164

(22) 国際出願日: 2024年6月3日(03.06.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-104744 2023年6月27日(27.06.2023) JP

(71) 出願人: 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 加藤 圭悟 (KATO Keigo); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 松村 和行 (MATSUMURA Kazuyuki); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 橋岡 佳子 (TATEOKA Yoshiko); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,

BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: NEGATIVE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, NEGATIVE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION COATING, NEGATIVE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION FILM, CURED FILM, AND SEMI-CONDUCTOR DEVICE USING THESE

(54) 発明の名称: ネガ型感光性樹脂組成物、ネガ型感光性樹脂組成物被膜、ネガ型感光性樹脂組成物フィルム、硬化膜、およびこれらを用いた半導体装置

(57) Abstract: Provided is a resin composition which exhibits excellent pattern processability in the form of a thick film and does not cause organic deposits even if processed on a substrate having an aluminum pad electrode. This negative photosensitive resin composition contains: at least one polymer compound selected from the group consisting of a polyamide, a polyimide, a polyamideimide and a polybenzoxazole as a component (A); a cationic polymerizable compound as a component (B); and a cationic photopolymerization initiator as a component (C). The negative photosensitive resin composition is characterized in that the content of fluorine atoms in the component (A) is 1 mass% or less.

(57) 要約: 厚膜での優れたパターン加工性を有し、かつアルミパッド電極を有する基板上で加工処理を行っても有機堆積物が生じない樹脂組成物を提供する。(A)成分としてポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、及びポリベンゾオキサゾールからなる群より選ばれる少なくとも1つの高分子化合物、(B)成分としてカチオン重合性化合物、(C)成分として光カチオン重合開始剤を含有するネガ型感光性樹脂組成物であって、前記(A)成分に占めるフッ素原子の含有量が1質量%以下であることを特徴とするネガ型感光性樹脂組成物である。

WO 2025/004697 A1